

<<SMT工艺>>

图书基本信息

书名：<<SMT工艺>>

13位ISBN编号：9787040360189

10位ISBN编号：7040360187

出版时间：2012-9

出版时间：高等教育出版社

作者：辜小兵，杨清德，林安全，等编

页数：178

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<SMT工艺>>

内容概要

《中等职业教育示范校建设精品教材系列：SMT工艺》根据相关教学指导方案并参考行业职业技能鉴定规范编写而成。

《中等职业教育示范校建设精品教材系列：SMT工艺》内容包括锡膏的搅拌、储存及印刷工艺，点胶工艺，贴片工艺，回流焊工艺，检测工艺和返修工艺。

《中等职业教育示范校建设精品教材系列：SMT工艺》根据生产实际，以SMT生产工艺为主线，整个工艺的教学过程基本就是生产实施的过程。

为了适应中职学生的特点，本书内容强调的是如何做，并通过大量的图片展示操作过程，让学生能按照教材真正动起来。

本书体现以任务引领、工作过程导向的职业教育教学理念，每个工艺都安排有具体操作任务，力求使技能教学在学生动手中进行，使学生的学习与生产实际紧密结合。

通过本书封底所附学习卡，可登录网站上网学习及获取相关教学资源。

学习卡兼有防伪功能，可查询图书真伪，详细说明见书末“郑重声明”页。

本书可作为中等职业学校电工电子类专业教材，也可作为器件设计、电路设计等与SMT相关的其他专业的辅助教材。

<<SMT工艺>>

书籍目录

工艺1 锡膏的搅拌、储存及印刷任务1 锡膏的手动搅拌及储存任务2 用锡膏搅拌机搅拌锡膏任务3 锡膏的手动印刷任务4 锡膏的自动印刷学习检测工艺2 点胶任务1 手动点胶任务2 用点胶机自动点胶学习检测工艺3 贴片任务1 手动贴片任务2 全自动贴片学习检测工艺4 回流焊任务1 台式回流焊任务2 全热风无铅回流焊学习检测工艺5 检测任务1 用目测法检测任务2 用光学设备检测学习检测工艺6 返修任务1 用电烙铁返修任务2 用焊接返修工作台返修学习检测参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>